

義守大學「電子構裝」學程

93 學年度第2 學期第2 次教務會議通過(94.06.15)
95 學年度第2 學期第3 次教務會議修正通過(95.12.13)
97 學年度第2 學期第2 次教務會議修正通過(98.06.29)
103 學年度第2 學期第2 次教務會議修正通過(104.05.22)
112 學年度第1 學期第1 次教務會議修正通過(112.12.18)

壹、學程目的：

配合政府『兩兆雙星』計畫且國內 IC 構裝產業佔世界第一，有鑑於半導體封裝測試需要大量電子、機械、化工、材料等工程專業人才，本學程提供學生技能整合、第二專長的就業能力。

貳、發展重點與特色：

本學程以『IC 構裝測試與可靠度分析』為共同核心必修課，另結合電子工程學系、機械與自動化工程學系、化學工程學系、材料科學與工程學系的課程，培育學生對半導體構裝技術與發展的認知。

參、實施對象：

本校工學院、智慧科技學院二至四年級學生。

肆、課程系統：

- 一.本學程共需修滿十八學分始得發給證書。且至少應有六學分不屬於主修學系應修之學分數，課程資料請參閱課程表。
- 二.在半導體相關公司進行校外實習，可抵相關課程之學分。相關課程之認定由學程委員認定。

伍、學程開始日期：九十八學年度。

陸、申請日期：依學校行事曆規定提出申請。

柒、申請程序：

先向原肄業學系提出申請，經原學系系主任核准後，再交由電子工程學系、機械與自動化工程學系、化學工程學系、材料科學與工程學系共同組成之委員會審核，通過後送機械與自動化工程學系系辦登記。

捌、修習證書：修畢應修課程且成績及格者，將頒發證書，並記載所修習課程科目。

玖、主辦單位：

本學程委員會，每學期至少開會一次，共同規劃、討論、議決學程相關事宜。學程委員會之委員由電子工程學系、機械與自動化工程學系、化學工程學系、材料科學與工程學系系主任組成，並由機械與自動化工程學系系主任擔任召集人，共計四人。



「電子構裝」學程課程表

課程分類	課程名稱	必修/ 選修	學分	開課系級	備註
1、基礎 課程(八 選二)	電路學(一)	選	3	電子系二上	
	電子學(一)	選	3	電子系二上	
	材料力學	選	3	機械系二下	
	熱傳學	選	3	機械系三下	
	有機化學(一)	選	3	化工系二上	
	化工熱力學(一)	選	3	化工系三上	
	材料科學導論(一)	選	3	材料系一上	
	高分子材料概論	選	3	材料系二下	
2、專業 核心 (一科)	IC 構裝測試與可靠度分析	必	3	機械系四上或四下	邀請校外實務專家授課 6 小時，視為外系課程。
3、專業進 階(十四 選三)	電子構裝技術	選	3	電子系四上或四下	
	印刷電路板工程	選	3	電子系二上或二下	
	電子系統冷卻技術	選	3	機械系四上或四下	
	IC 構裝原理與實務	選	3	機械系四上或四下	
	材料缺陷分析	選	3	材料系四上或四下	
	※電子元件製作技術	選	3	電子系二上或二下	此四門課為四選一課程。
	※半導體製程	選	3	機械系四上或四下	
	※半導體製程	選	3	化工系四下	
	※半導體製程技術	選	3	材料系四上或四下	
	◎高分子加工與物性	選	3	化工系四上	此三門課為三選一課程。
	◎高分子材料加工原理與應用	選	3	材料系三上或三下	
	◎高分子材料物性	選	3	材料系三上或三下	
	液晶顯示器之驅動 IC 可撓式可靠度分析介紹	選	3	材料系三上或三下	此兩門課為二選一課程
	液晶顯示器之驅動 IC 可撓式封裝材料分析介紹	選	3	材料系三上或三下	



義守大學修習「電子構裝」學程申請表

申請日期： 年 月 日

姓名：	學號：	聯絡電話：
通訊地址：		
E-mail：		
原屬學系：	學院	系 年級 班
原屬學系導師：		
原屬學系系主任意見：		
學程申請審查意見：		
備註： 1. 請附一張歷年成績單。 2. 原屬學系系主任簽核後請將申請表繳交回機械系辦公室，以利審查。		



義守大學「電子構裝」學程證書申請表

申請日期： 年 月 日

姓名：		學號：		聯絡電話：	
院系年級別	學院		學系	年級	班
☐ 申請中文證書 ☐ 申請英文證書，英文姓名：					
郵資： 元 ☐ 已付_____					
☐ 證書自取 ☐ 請代為郵寄，住址如下：					
通訊地址(證書寄發地址)：					
E-mail：					
學程委員會審核結果：					
通過： ☐					
不通過： ☐					
※本學程共需修滿十八學分始得發給證書。且至少應有六學分， 不屬於主修學系應修之學分數，課程資料請參閱課程表。 ※在半導體相關公司進行校外實習，可抵相關課程之學分。 相關課程之認定由學程委員認定。 ※請附歷年成績單。 ※繳交本表時，請將 成績單正本 裝訂於後。					
學程承辦單位 承辦人章戳			學程承辦單位 主管章戳		



「電子構裝」學程成績檢核表

學系：

姓名：

學號：

課程分類	課程名稱	必修/選修	學分	開課系級	已修	分數
1、基礎課程 (八選二)	電路學(一)	選	3	電子系二上		
	電子學(一)	選	3	電子系二上		
	材料力學	選	3	機械系二下		
	熱傳學	選	3	機械系三下		
	有機化學(一)	選	3	化工系二上		
	化工熱力學(一)	選	3	化工系三上		
	材料科學導論(一)	選	3	材料系一上		
	高分子材料概論	選	3	材料系二下		
2、專業核心 (一科)	IC 構裝測試與可靠度分析	必	3	機械系四上或四下		
3、專業進階(十四選三)	電子構裝技術	選	3	電子系四上或四下		
	印刷電路板工程	選	3	電子系二上或二下		
	電子系統冷卻技術	選	3	機械系四上或四下		
	IC 構裝原理與實務	選	3	機械系四上或四下		
	材料缺陷分析	選	3	材料系四上或四下		
	※電子元件製作技術	選	3	電子系二上或二下		
	※半導體製程	選	3	機械系四上或四下		
	※半導體製程	選	3	化工系四下		
	※半導體製程技術	選	3	材料系四上或四下		
	◎高分子加工與物性	選	3	化工系四上		
	◎高分子材料加工原理與應用	選	3	材料系三上或三下		
	◎高分子材料物性	選	3	材料系三上或三下		
	液晶顯示器之驅動 IC 可撓式可靠度分析介紹	選	3	材料系三上或三下		
	液晶顯示器之驅動 IC 可撓式封裝材料分析介紹	選	3	材料系三上或三下		
審核結果	◎核心課程	學分	◎請附歷年成績單。 ◎本學程共需修滿十八學分始得發給證書。且至少應有六學分不屬於主修學系應修之學分數，課程資料請參閱課程表。 ◎在半導體相關公司進行校外實習，可抵相關課程之學分。相關課程之認定由學程委員認定。			
	◎一般課程	學分				
	◎總修學分	學分				
	審核結果： 通過： ☐ 不通過： ☐					
學程承辦單位承辦人章戳						

